IRDA-WELDER　用户使用手册

型号:T862

泰安普惠电气科技有限公司

http://www.tech168.cn

目 录

1. 产品特点……2
2. 主要参数……2
3. 主要部件……2
4. 主要部件功能说明……3
⑴主体……3
⑵前面板……3
⑶后面板……4
⑷调焦支架……4
5. 装机步骤……5
⑴装入导柱……5
⑵装入定位环……5
⑶整体装配……5
⑷连接红外灯体连接线……6
6. 使用说明……6
⑴开机……6
⑵拆焊……7
⑶回焊……7
⑶936 使用……7
7. 注意事项！……8

产品特点。

● 采用自主研发的红外线拆焊技术。

● 专用红外线加热，穿透力强,器件受热均匀,突破传统热风拆焊机罩住元件加热，热衝擊较大缺点。
● 操作容易，经过一天训练即可完全操作本机。
● 无需拆焊治具 ，本机可拆焊 15x15-25x25mm 所有元件。
● 本机配备 650W 预热溶胶系统 ， 预热范围 120x80mm。
● 红外线加热无热风流动，不会影响周边微小元件，可适用所有的元件，尤其是 Micro BGA 元件。

主要参数

电源电压	AC220v 50Hz
功　　率	600W
温度范围	100℃-350℃

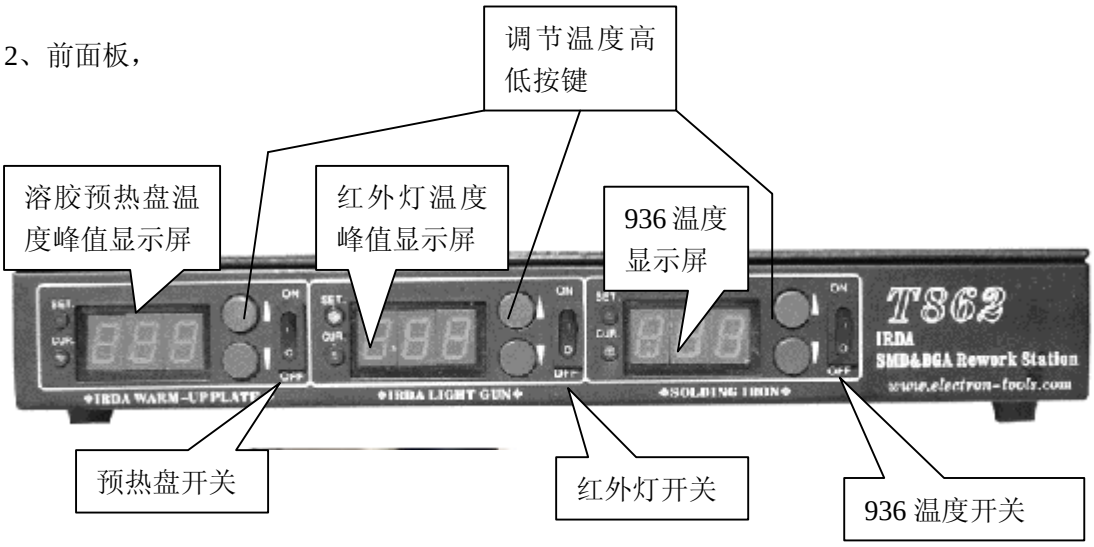
主要部件

底盘	1
导柱	1
灯体	1
定位环	1
线路板支架	1
936 烙铁头	1
烙铁架	1
电源线	1
用户使用手册	1

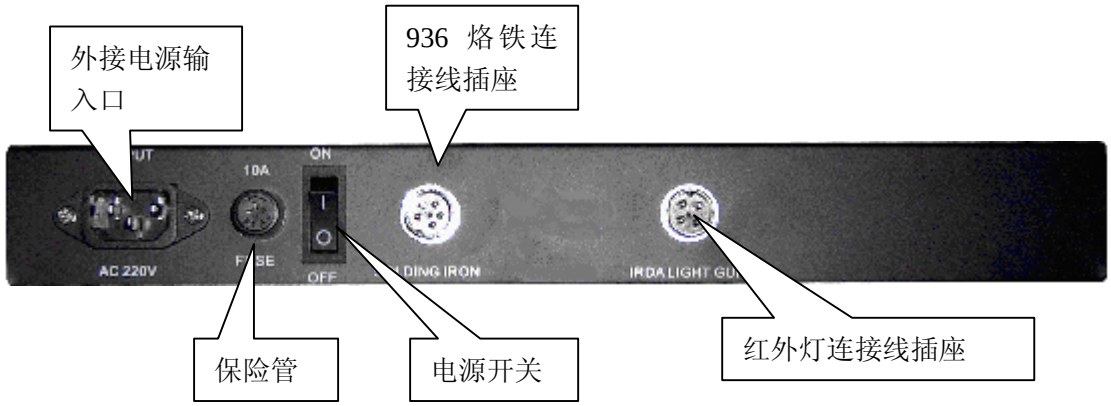
主要部件功能说明

1、主体。

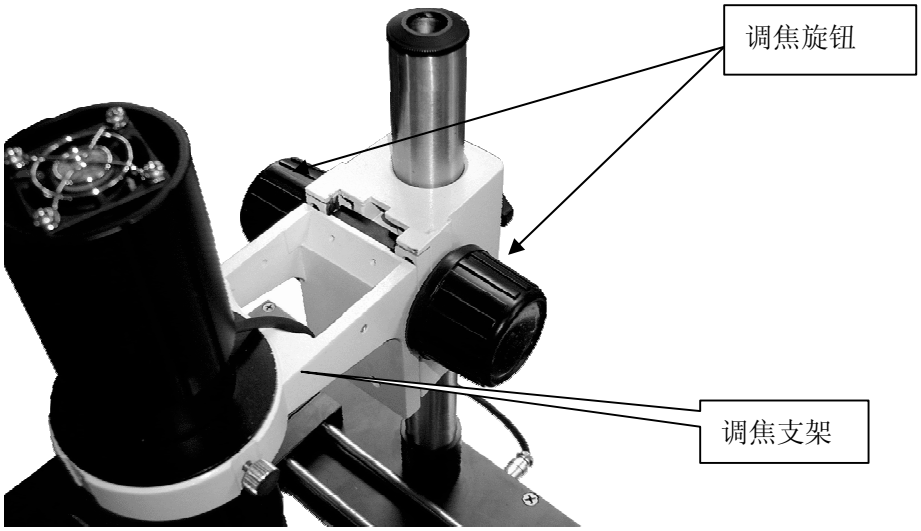
2、前面板，

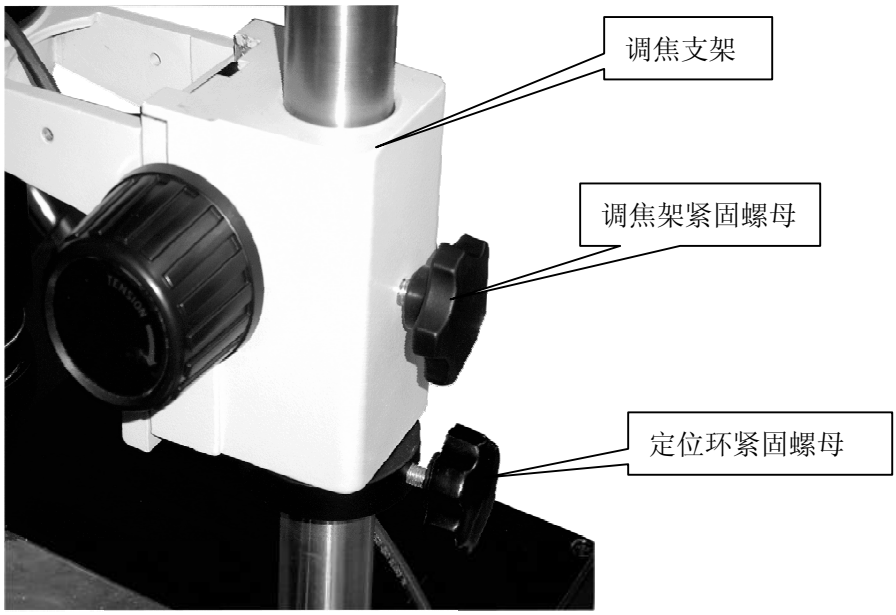


3、后面板


外接电源输入口
936 烙铁连接线插座
10A
ON
OFF
AC 220V
保险管
电源开关
红外灯连接线插座

4、调焦支架。

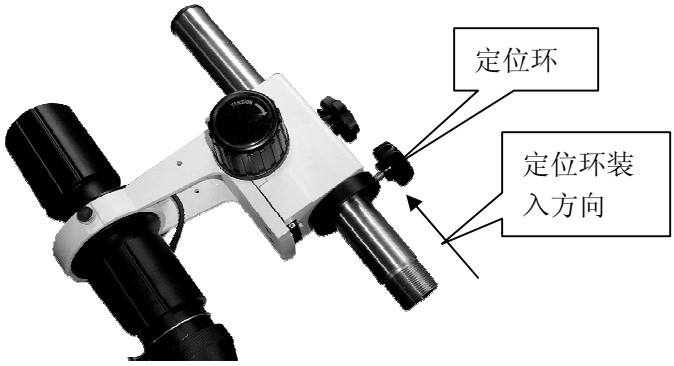

调焦旋钮
调焦支架


调焦支架
调焦架紧固螺母
定位环紧固螺母

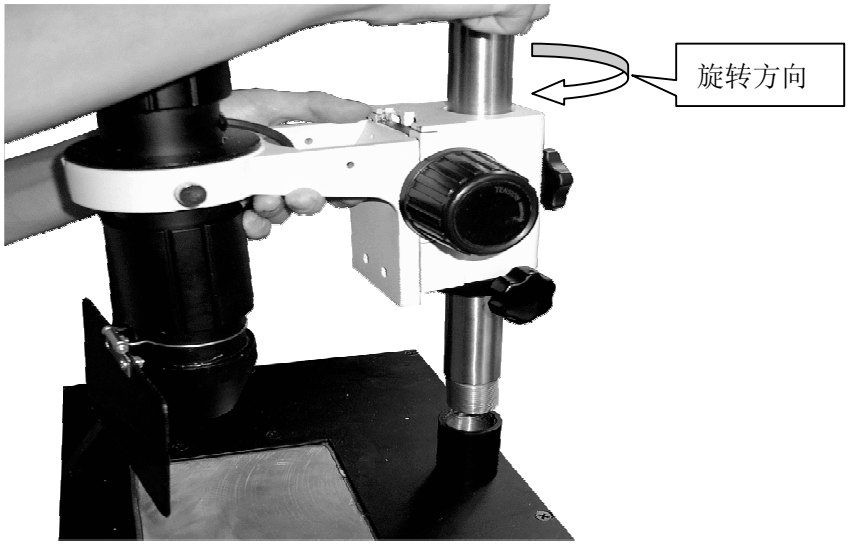
装机步骤

1、装入导柱。首先放松调焦架紧固螺母，再按箭头指示方向插入导柱。

2、装定位环。放松定位环紧固螺母，再按箭头指示方向装入定位环，装入后旋转定位环紧固螺母使其固定在相应高度。

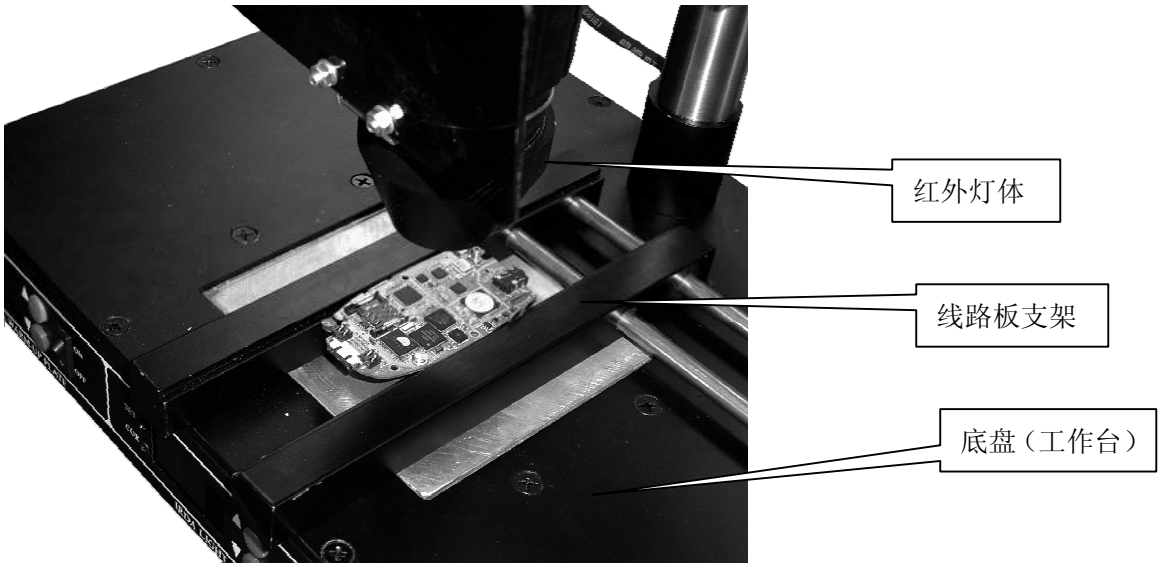


3、整体装配。①放松调焦架紧固螺母。②拿起调焦支架，使导柱对准底盘相应螺母，旋转导柱。③旋转调焦架紧固螺母使调焦架固定。



4、连接红外灯体连接线。①将连接线插头对准插入红外灯连接线插座。②向右旋转固定螺丝。

使用方法



⑴开机。①检查灯体及电源线是否连接好。

②开电源开关。等自检通过后再使用（面板显示屏上显示为上次使用时设定值）。

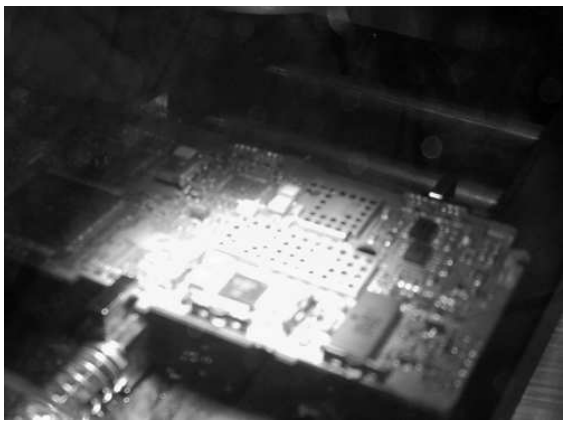
③放好线路板支架，将线路板固定在线路板支架上，调节定位环及调焦架旋钮，调整灯体高度。保持灯头与拆焊物件高度为 20-30㎜ 为宜。

④调节温度峰值。根据拆焊芯片大小，适当调节输出温度峰值，温度峰值由 100-350℃可调，折 15x15㎜ 芯片时，可调节到 240-300℃左右，拆 25x25㎜ 时，可调节温度峰值到 300-350℃，调到 350℃时，灯体直射，此时红外线光最强（请注意自我控制时间，防止芯片过热烧坏）。

⑤调焦距。灯体最小斑为直径 15㎜，最大可调焦斑直径 30㎜ 以上，视不同芯片而定。一般使用时，调节到距芯片高度 20-30㎜。可根据芯片大小，调节调焦旋钮。使光斑全罩住芯片为宜。

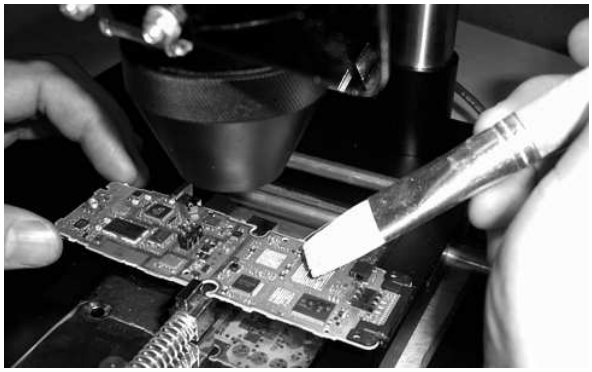
⑥开启前面板两个开关，分别控制预热熔胶盘和灯体工作，当线路板采用热熔胶粘贴时，可开启预热盘熔胶，否则建议采用相应措施为宜，熔胶温度不宜过高，一般为 120-160℃为宜。

⑵拆焊。 ①调节温度，使芯片对准焦距。



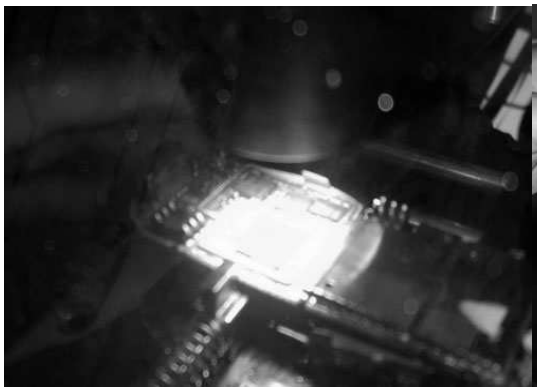
②经过适宜时间后，锡点熔化，取出芯片。

⑶回焊。①清洁焊盘。



②植焊盘锡球及涂敷助焊剂（不宜太厚，薄薄一层即可）。

③等待助焊剂挥发掉溶剂后，用夹子将回焊的芯片对准焊盘、放正，然后加温至锡球完全熔化，芯片自动焊入位置；等芯片充分冷却后，撤下线路板测试焊接效果；如果不行，请重新操作。



(4)936 烙铁使用.打开电源开关,设定所需要温度.

注意事项

1、工作完毕后，不要立即关电源，使风扇冷却灯体。
2、保持通风口通风，灯体洁净。
3、导柱、调焦支架适时用油脂擦拭
4、长久不使用，应拔去电源插头。
5、小心，高温操作，注意安全。